

株式会社東京精密 2024年度(2025年3月期) 第2四半期 決算説明会
質疑応答 要約

2024年11月1日 開催

- 本資料は、上記日時に開催された2024年度(2025年3月期) 第2四半期 決算説明会(Web開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
 - 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
 - なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」と表記します。
1. **7-9月期 SPE 受注における生成 AI 向け受注高と、パワー半導体関連の受注構成比率についてコメントをいただきたい。**
 - 7-9月期の生成 AI 受注は、前回の説明会で述べた水準で着地した。なお、今回より、競争上の観点から、定量的な説明を控えることとした。
 - パワー半導体向けの受注高は、SPE の 9-10%で、うち SiC は 7%程度。従前と比較すると比率は低下しており、受注は減速基調が続くと想定している。
 2. **7-9月期の SPE 営業利益率が 4-6 月対比で大幅に改善している理由を確認したい。**
 - 4-6 月期比での売上増加が主因であり、プロダクトミックスなどの要因はない。
 3. **2024 年度下期の SPE の売上予想を上方修正した背景と、下期 SPE 受注高が上期比で増加すると考えている背景、市場前提を伺いたい。**
 - 民生関連の SPE 需要が軟調な中、生成 AI ・中国需要が堅調であることが主因。
 - 更にこの先も、生成 AI デバイス ・ HBM 等も世代交代が進むことで、テクノロジー ・ バイ需要が続くと想定している。
 4. **その生成 AI に関して、2024 年度下期の受注水準、構成比の想定を伺いたい。**
 - 上期比約 20%増としてガイダンスに織り込んでいる。なお、これは保守的に見積もったものであり、商談ベースでは 50%程度の増加もありえる。
 - 受注構成として、HBM 用途だけではなく、足許で好調な AI ロジック半導体向けのグライндаの増加も想定している。そのため、この下期の生成 AI 受注構成比は、AI ロジック用途と HBM 用途を 65 : 35 の割合で織り込んでいる。

5. 7-9月期のSPE受注高ガイダンスの10-12月期、1-3月期の水準を確認したい。
 - SPE全体で、10-12月期/1-3月期 ほぼ同水準の受注高を計画している。

6. SPEの受注残高納期別分布とリードタイムに関するコメントをいただきたい。
 - 2024年9月末のSPE受注残高のうち、6割程度が2024年度中の売上計上を見込んでいる。残りの4割は2025年度以降となり、リードタイムが相対的に長いグラインダが多く含まれている。
 - 現時点でのリードタイムは、概ねプローバ・ダイサで2-4か月程度、グラインダは引き続き半年超となっている。

7. Hybrid Bonding 関連したSPEの適用時期に関して、会社の見通しを確認したい。
 - 現時点では顧客評価が行われており、順調に進んでいる。
 - 初期ロット受注が2024年度下期に入るとの想定は維持しているが、期を跨ぐ可能性は否定しない。
 - 暦年2025年後半から初期の量産に向けた装置納入が始まると推定している。暦年2026年前半に量産が本格的に拡大するかどうかは不透明。

8. 会社は生成AI関連装置市場が引き続き拡大すると考えているようだが、詳しくコメントをいただきたい。
 - 市場にはHBMの供給過剰による減速懸念があることを承知しているが、HBMは足許で世代交代が進んでおり、これに伴う測定時間の増加はプローバの需要を拡大させる可能性がある。
 - 更に、測定時にウェーハの温度を高精度で制御するニーズが、世代交代のたびに高まってゆくことに伴うプローバの需要拡大も想定される。

9. 2025年度以降のSPE営業利益率について、収益性の悪化リスクや、生成AI事業機会の拡大による改善リスクなどを含め、見解をいただきたい。
 - 生成AI等、一部のデバイス市場のみ堅調な昨今においては、競争の激化による販売価格への下押し圧力がある。
 - また部材価格や外注コストの高騰が利益率の圧迫要因になっているが、当社は設計変更や加工方法の変更を継続しており、利益率改善の目は立っている。

10. 計測セグメントにおいて、従来製品(汎用計測・自動計測)の業容、充放電試験システム需要の獲得による業容のさらなる拡大の余地について見解をいただきたい。
 - 汎用計測・自動計測は、先行指標と言える工作機械受注が厳しい水準にある中で

も、楽観視はできないが回復の兆しがみられており、COVID-19 パンデミック前の水準に近付きつつある。

- 充放電試験システム事業は、機器販売・受託評価 両方で事業機会が増加している。クルマの電動化への大きな流れに変化は無く、また社会全体の省エネ化などにより二次電池全体に市場拡大の余地がある。さらに、設備投資において国の支援があることが大きく、顧客の設備投資意欲は非常に高い。

11. 会社の今後の設備投資額水準に関してコメントをいただきたい。

- 今年度の計画は期初からの 95 億円を据え置いている。これには、2025 年 7 月竣工予定の名古屋工場に関する投資や、規模は小さいが買収した米国子会社におけるバランサの工場建設が含まれている。
- なお、名古屋工場竣工後のさらなるキャパシティ拡大に向けた投資計画も検討課題と考えている。

12. 一部前工程メーカーは中国需要減速の可能性を示唆しているが、当社の考えはどうか。

- 足許ではパワー半導体関連の需要は減速している。
- 一方で、中国メーカーが AI やハイエンドの半導体生産に力を入れており、当社においても関連需要がプローバを中心に増加している。米中貿易摩擦によるリスクを考慮する必要はあるが、プローバやグライндаの需要は現時点では強い。

13. 当社は、AI 関連のプローバの事業機会としてはメモリ向けとコメントをしていたが、今後、ロジック用途の拡大に関しても手ごたえがあるとの考えでよいか。

- その考えでよい。

14. 会社は 2024 年度下期以降のグライнда受注機会の拡大に期待を示しているとの理解は正しいか、また、需要が急速に拡大した場合の供給リスクに関して、当社のキャパシティを踏まえ説明いただきたい。

- 今後も増加する可能性は十分にあると考える。
- また、Hybrid Bonding の量産展開が本格化したタイミングでは、10 台/月の出荷水準も十分あり得ると考えている。
- 仮に需要が供給を上回る状況になっても、足許で軟調さが続く SiC 関連グライндаのスペースを活用することで当面は対応可能と考えている。

15. 会社に対する資本市場の評価に関してコメントをいただきたい。

- 現在は実行すべき施策を確実に実行することで事業の成長と株価の上昇を実現していくことが一番必要なことであると考えている。

- 当社の対象市場は拡大するという確信を持っている。その観点では、需要に対応できるキャパシティを確保するための投資を行うことが最重要課題と考えて取り組んでいる。
- また、他社との協業が可能な分野では協業関係を広げていきたい。

以上